

一. T101 产品及核心参数

T101 采用 LCC 封装，支持 NB-IoT/eMTC/GSM 制式，可满足客户多类物联网应用需求，包括在智能表计、智慧停车、智慧井盖、智慧路灯、资产管理等丰富的物联网应用领域。

产品亮点

- ❑ 高通 MDM9206
- ❑ 支持通信接口类型多
- ❑ 支持 NB-IoT/eMTC/GSM
- ❑ 频段覆盖广
- ❑ 支持 BD/GPS/GLONASS
- ❑ 超低功耗

数据特性

- ❑ Cat NB : 200Kbps / 200Kbps
- ❑ eMTC: 1Mbps / 1Mbps
- ❑ GSM: 236.8 kbps / 236.8 kbps

模块接口

- ❑ USB
- ❑ UART1(8-wires)& UART2(2-wires)
- ❑ SIM interface (1.8/3.0V)
- ❑ I2S
- ❑ SPI
- ❑ SDIO
- ❑ I2C
- ❑ Antenna (RF PAD for Primary and GPS)
- ❑ LED indication
- ❑ ADC
- ❑ GPIO
- ❑ WAKEUP-IN/WAKEUP-OUT

电气&灵敏度

- ❑ Transmit Power:
 - LTE: 23 ±2.7dBm (Power Class 3)
- ❑ Power Supply :
 - 3.3V~4.2V (3.8V is recommended)

基本属性

- ❑ Platform:MDM9206
- ❑ Frequency Band :
 - LTE FDD:B1/B3/B5/B8
 - GSM: QUAD BAND
 - GPS L1: 1575.42MHz
- ❑ LCC Form Factor (80 pins)
- ❑ Dimensions: 30mm*30mm*2.3mm
- ❑ Weight: About 4.0g
- ❑ GPS/GLONASS/BD
- ❑ PSM&eDRX
- ❑ Control via AT commands AT commands:
 - 3GPP TS 27.007 and 27.005
 - PCTX extended AT command

驱动&工具

- ❑ Drivers
 - Windows XP, 7,8, 10
 - Linux
 - Android
- ❑ Firmware Update Tool

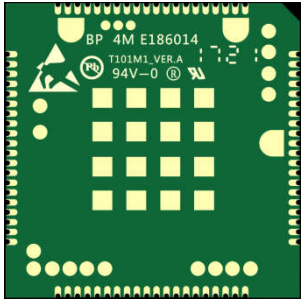
应用特性

- ❑ Support embedded TCP & UDP protocols
- ❑ PPP
- ❑ CoAP
- ❑ OMA LWM2M
- ❑ MQTT

环境适应性

- ❑ Operation temperature: -40° C to +85° C
- ❑ Storage temperature: -40° C to +85° C
- ❑ Humidity: 5%~ 95%

二. 模组正反面

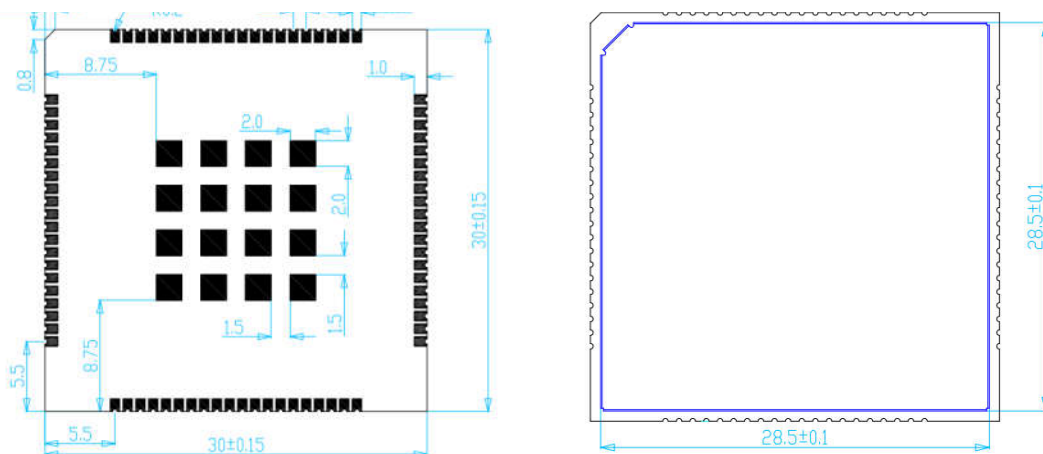


三. 详细参数列表

产品特性		描述
电源特性		
工作电压		3.3V~4.2V（推荐值 3.8V）
移动通信部分		
工作频段		LTE HD-FDD: B1 (2100 MHz) B3 (1800 MHz) B5 (850MHz) B8 (900 MHz) GSM: GSM850 GSM900 GSM1800 GSM1900 GNSS L1 : 1575.42MHz
数据业务	NB-IOT	Cat NB : 32Kbps(DL) /62Kbps(UL) eMTC: 375Kbps(DL) / 375Kbps(UL) GPRS: 85.6 Kbps(DL) / 85.6 Kbps(UL) EDGE: 236.8 Kbps(DL) / 236.8 Kbps(UL)
GNSS 部分		
追踪灵敏度		-155dbm（参考实测值为准）
捕获灵敏度		-145dbm（参考实测值为准）
冷启动时间		小于 30 秒（参考实测值为准）
热启动时间		小于 5 秒(参考实测值为准)

定位精度		小于 2m（参考实测值为准）
公共部分		
温度	正常工作温度	-30℃～+75℃
	受限工作温度	-40℃～+85℃
	存储温度	-40℃～+85℃
环境湿度		5%~95%
功耗		PSM 模式： 9uA Idle 模式： 4mA
天线连接器		天线连接器（RF Connector）×2（MAIN, GNSS）
LCC 接口		电源接口 USB2.0 High-Speed 接口 UART 接口 USIM/SIM 卡接口（支持 3V、1.8V） I2S、SPI、SDIO、I2C、ADC、GPIO Antenna (RF PAD for Primary and GPS) 复位接口 指示灯接口 休眠控制接口
结构尺寸		LCC 封装模块尺寸： 30*30*2.3
重量		LCC 封装模块重量： 4.3±0.2g

四. 详细尺寸图



五. 技术支持及售后

- ❑ 提供外围参考原理图，并协助客户原理图和 PCB review；
- ❑ 提供 Demo 板，及各种软硬件驱动支持；
- ❑ 客户问题第一时间响应；